

NOTES ;

1. THIS PRODUCT WAS USED FOR POST MOLD ON SHIELDED MT-MODU.
2. A PROCESS OF ASSEMBLY : SEE A PICTURE 1.
- ③ NUMBER OF POSITIONS PERTAINS TO ASSOCIATED COMPONENTS.
- ④ ATTENTION ; DON'T NIP SIGNAL WIRE BETWEEN SUPPORT HOUSING AND SHIELD SHELL AFTER HOUSING SET FOR SIGNAL WIRE.

注記 :

1. 本製品は、シールド MT-MODU コネクタにポストモールドを施す時に用いる。
2. アセンブリ方法：図1参照
- ③ 通用ケーブル・ケーブル極数
- ④ 本製品をワイヤ面にセット後、シールドの間にワイヤをはさみ込まない様に十分注意する事。

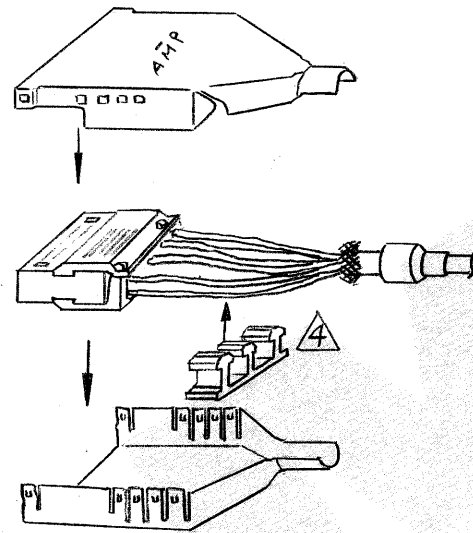


図1 アセンブリ方法

FIG. 1



50.8	45.7	9	50	-4
15.2	10.2	2	18.20	-3
10.2	5.1	1	16	-2
5.1	-	-	8,10	174068-1
L REF	A REF	N	極数	型番
			③ POS	PART NUMBER

0	RELEASED	ECN NO. J-9249	DR. J. Enomoto	3-19-86
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

© 1986 年 日本イー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1986 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
絶縁電線断面積(WIRE RANGE) mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) サポート・ハウジング, シールド MT-MODU ケーブル・ケーブル			
材料 (MATERIAL) 注記 ④参照 SEE NOTE ④	仕上 (FINISH)	一般公差	SYZE	LOC	番号 (NO.)
DR. J. Enomoto	DE. J. Enomoto	10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	C	J	C-174068
CHK. J. Enomoto	APP. J. Enomoto	尺度 (SCALE)	REV.	0	SHEET 1 OF 1

PROP. NO. 85-25908 PROJ. 551-213

PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST